

5-103669-3

✓ 生産可能

AMPMODU | AMPMODU MTE

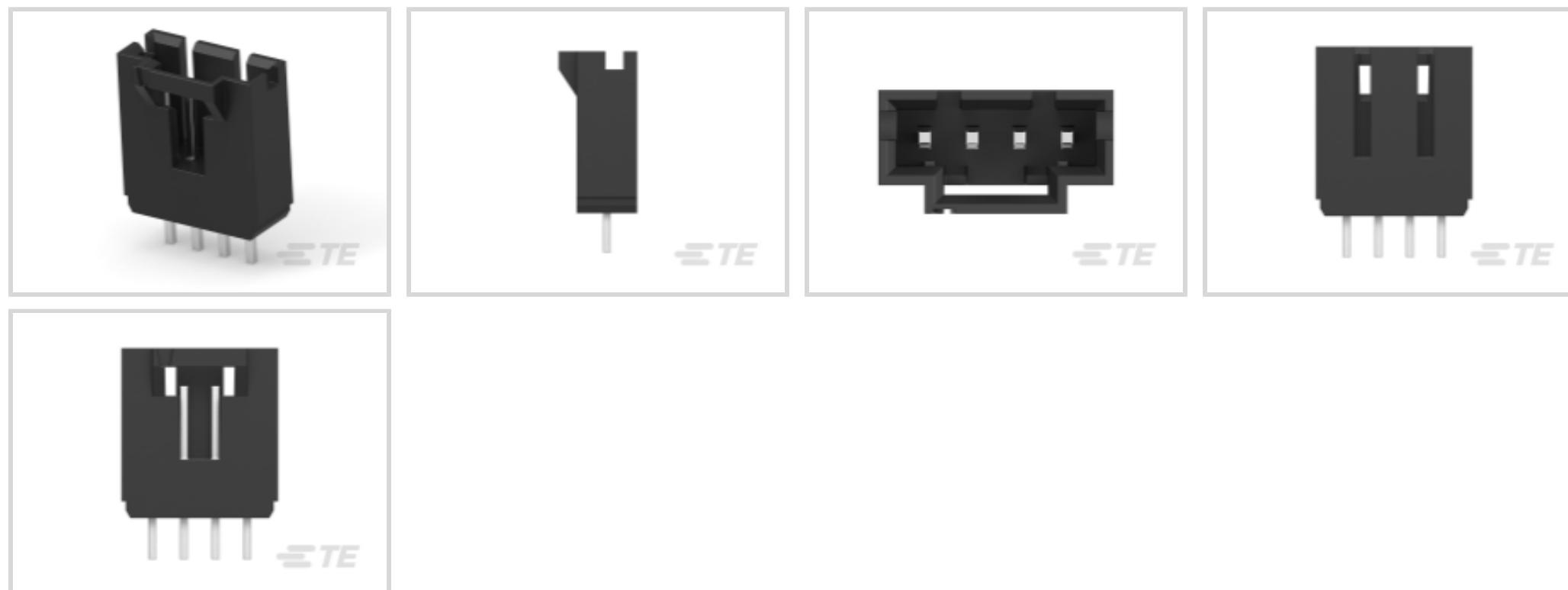
型番: 5-103669-3

PCB Mount Header, Vertical, Wire-to-Board, 4 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin, Through Hole - Solder, Signal, AMPMODU MTE

[TE.comを見る>](#)



コネクタ > PCB コネクタ > PCB ヘッダおよびリセプタクル



PCB コネクタ アセンブリのタイプ: PCB マウント ヘッダ

PCB マウント向き: 垂直

接続タイプ: 電線対基板

極数: 4

列数: 1

特徴

電気的特性

結線抵抗 15 mΩ

絶縁抵抗 5000 MΩ

誘電耐電圧 (最大) 600 V

寸法

基板厚 (推奨) 1.57 mm [.062 in]

コネクタの高さ 13.59 mm [.535 in]

コネクタ長 12.7 mm [.5 in]

実装の特徴

パッケージ数量 42

実装方法 Tube, Box

業界スタンダード

認可規格製品に適合 UL E28476, CSA LR7189

UL 難燃性グレード UL 94V-0

使用条件

使用温度 (最大)	105 °C[221 °F]
使用温度範囲	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

機械的アタッチメント

嵌合保持のタイプ	留め具
嵌合保持	あり
嵌合調整のタイプ	ラッチ付き, 極性
PCB マウント リテンションタイプ	スエージされたリテンション用リード
PCB マウント リテンション	あり
PCB マウント アラインメント	なし
コネクタ取り付けのタイプ	ボード マウント
嵌合調整	あり

結線の特徴

結線ポストとテールの長さ	3.3 mm[.13 in]
角型結線ポストとテールの寸法	.64 mm[.025 in]
PCB に対する結線方法	スルー ホール - はんだ付け

端子の特徴

端子の下地めっきの材料	ニッケル
端子の下地めっきの材料の厚さ	1.27 μm [50 μin]
PCB 端子結線面のめっき材料の仕上げ	マット
端子嵌合面のめっき材料の厚さ	2.54 μm [100 μin]
嵌合可能な角形ポストの寸法	.64 mm[.025 in]
端子の形状およびフォーム	角型
PCB 端子結線面のめっき材料の厚さ	2.54 μm [100 μin]
端子嵌合面の長さ	5.84 mm[.23 in]
端子のベース材質	銅合金
PCB 端子結線面のめっき材料	錫
端子嵌合面のめっき材質の仕上げ	光沢
端子嵌合面のめっき仕様	錫
端子のタイプ	ピン
端子の定格電流 (最大)	3 A

ハウジングの特徴

ハウジングの材料

ガラス繊維入り熱可塑性樹脂

ピッチ

2.54 mm [.1 in]

製品のタイプの特徴

PCB コネクタ アセンブリのタイプ

PCB マウント ヘッダ

接続タイプ

電線対基板

ヘッダーのタイプ

完全にシュラウド付き

防水性

いいえ

コネクタおよびコンタクトの嵌合先

プリント基板

構成の特徴

PCB マウント向き

垂直

極数

4

列数

1

ボディの特徴

一次製品色

黒

動作/用途

回路用途

Signal

その他

EU RoHS 準拠

準拠

EU ELV 準拠

準拠

製品コンプライアンス

コンプライアンス資料に関しては、TE.comの製品ページをご覧ください>

EU RoHS指令2011/65 / EU

指令に適合

EU ELV指令2000/53 / EC

指令に適合

中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016

閾値を超える物質は有りません。

EU REACH規則 (EC) No. 1907/2006

ECHAによる現在の候補リスト: 2024年6月(241)

候補リストの表記: 2024年6月(241)
REACH SVHCを含まない

ハロゲン含有量

低ハロゲンの場合は Br, Cl, F, I が均質材料あたり 900 ppm 未満であり、又 BFR/CFR /PVC が無いこと

はんだ処理能力

最大 260°C でリフローはんだ付け可能

製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されることがあります。TEがEU RoHS（特定有害物質使用制限）指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2011/65/EU（RoHS2）の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器には、指令2011/65/EUの定めるところにより、CEマークが与えられます。コンポーネントにはCEマークは与えられない場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀が0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC（ELV指令）の付属書で制限の免除について定義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁（ECHA）の「記事中の物質要件に関するガイド」URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>に基づいたSVHCを記載しています。

適合製品



TE製品番号: 103648-3
04 MTE RCPT HSG SR RIB .100CL



TE製品番号: 487526-3
004 HOUSING FFC RCPT 100CL SR



TE製品番号: 5-103959-3
5X4 MTE RCPT SR LATCH .100CL



TE製品番号: 5-103956-3
5X4 MTE RCPT SR LATCH .100CL

関連シリーズ | AMPMODU MTE



PCB ヘッダおよびリセプタクル(444)



コネクタ キャップおよびカバー(18)



コネクタ ハードウェア(1)



コネクタ端子(27)



基板対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル(24)



挿入および引き抜き工具(1)

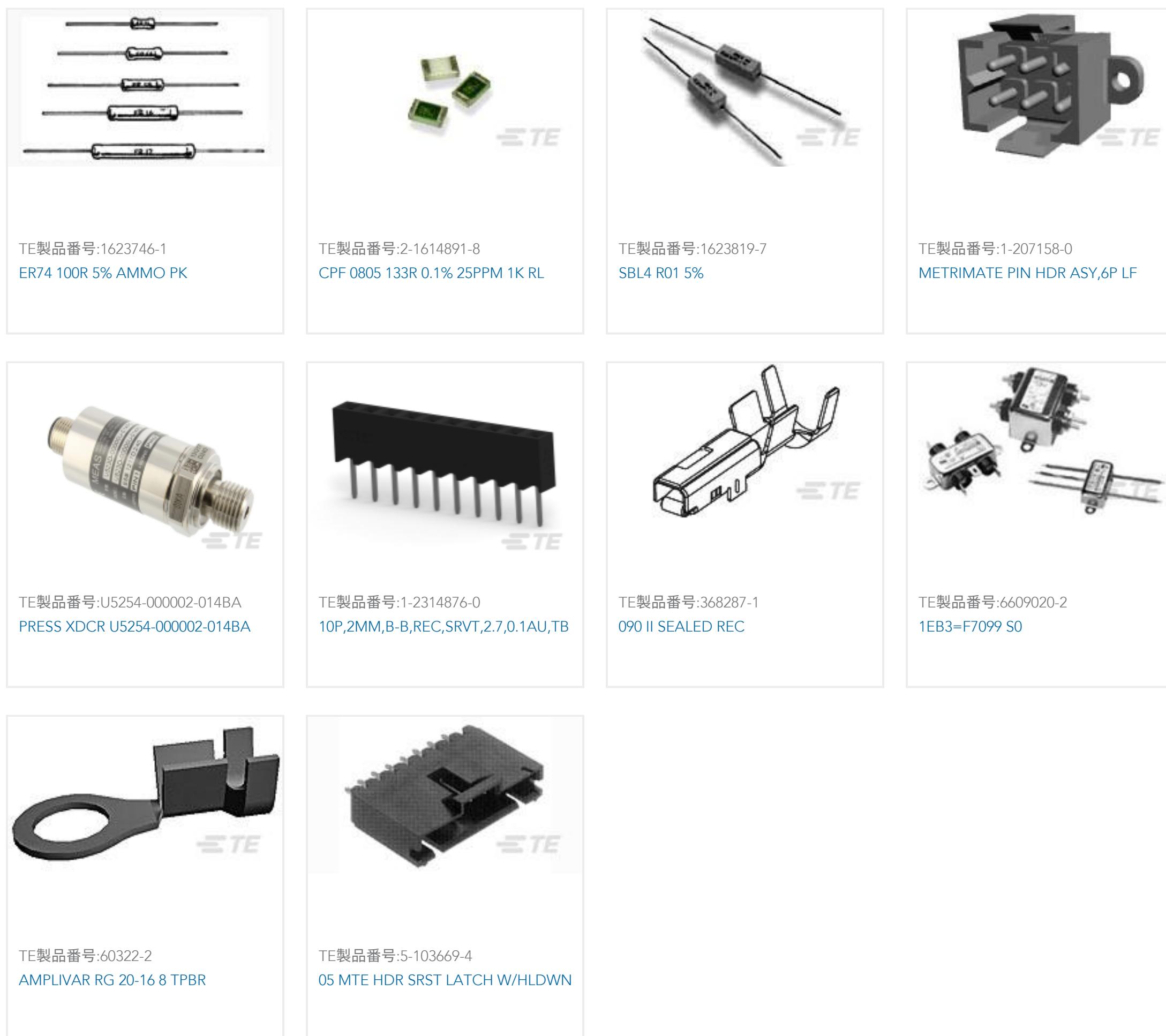


電線対基板コネクタのアセンブリおよびハウジング(298)



電線対基板接続用ヘッダーおよびリセプタクル(420)

この製品と一緒に購入されている製品



書類

製品図面

04 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN

英語

CAD ファイル

3D モデル

3D

カスタマービューモデル

[ENG_CVM_CVM_5-103669-3_AB.2d_dxf.zip](#)

英語

カスタマービューモデル

[ENG_CVM_CVM_5-103669-3_AB.3d_igs.zip](#)

英語

カスタマービューモデル

[ENG_CVM_CVM_5-103669-3_AB.3d_stp.zip](#)

英語

CAD ファイルをダウンロードすることにより、[利用規約](#)に同意したこととなります。

データシート/カタログ ページ

[AMP MODU MTE Section of Catalog 1307819](#)

英語

[AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION5_CONT](#)

英語

[AMPMODU MTE INTERCONNECT SYSTEM](#)

英語

製品規格

取付適用規格

英語